

从内至外全栈自研 “纯血鸿蒙”预计四季度正式商用

◎刘逸鹏 记者 黎灵希

6月21日,华为开发者大会2024开幕, HarmonyOS NEXT和盘古大模型5.0等重磅亮相。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布, HarmonyOS NEXT从内到外实现全栈自研,是一个源自中国、自主可控的操作系统。自6月21日起, HarmonyOS NEXT面向开发者启动Beta测试,预计在今年第四季度正式商用。

华为常务董事、华为云CEO张平安发布盘古大模型5.0。盘古大模型5.0在全系列、多模态、强思维三个方面全新升级,推出适配不同业务场景的多种规格模型,加速大模型行业落地。

从内到外全栈自研

HarmonyOS操作系统于2019年8月9日正式发布。在过去的1778天, HarmonyOS历经4代,鸿蒙生态设备突破9亿台,吸引超过254万开发者。

此次揭开“面纱”的HarmonyOS NEXT是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代,又被业内称为“纯血鸿蒙”。

“纯血鸿蒙”纯在哪里?余承东介绍,“纯血鸿蒙”从内到外实现全栈自研。“这是一个源自中国、自主可控的操作系统”。

据悉,从操作系统内核、文件系统,到编程语言、编译器/运行时、编程框架,再到设计系统、集成开发环境以及AI框架和大模型等, HarmonyOS NEXT均全面焕新。

HarmonyOS NEXT以向下扎到根的技术,全面建立操作系统底座。在软件根技术创新的同时,通过系统架构的大胆创新和软硬芯云的深度整合, HarmonyOS NEXT的整机性能相比HarmonyOS 4提升30%。

华为终端BG软件部总裁龚伟表示,鸿蒙内核超越Linux内核,更安全,更流畅,对比之下性能提升10.7%。另外, HarmonyOS NEXT可实现整机性能提升30%,目标是每年再提升20%。

龚伟提到,鸿蒙不是安卓或iOS的平替,不是把代码重写一遍,而是重新设计用户体验。鸿蒙的典型特征是全景景体验,即便熟悉的功能也能够焕然一新。

除此之外, HarmonyOS NEXT实现一个系统造就了统一的生态,即手机、平板和智能屏等都能共享一个系统,开发者仅需开



发维护一个鸿蒙原生应用版本,便可在不同设备上带给消费者一致的体验。

鸿蒙“拼图”加速成型

操作系统的成功与否,取决于生态建设。上海证券报记者从大会现场了解到,自华为宣布启动鸿蒙原生应用开发以来,得到了广大伙伴和开发者的踊跃响应,涌现了大量的创新案例。

例如,美团重新设计了骑车体验,骑行一步扫码解锁,锁屏状态直接还车;钉钉与HarmonyOS NEXT深度融合,用户从系统日历中一键就可以开会,小艺语音助力直达会议,等等。

当前,鸿蒙原生应用已经进入全面冲刺阶段。截至目前,5000多个常用应用已全部启动开发加入,其中超过1500个应用已经完成上架,诸多领域已启动鸿蒙原生应用开发。

“我们坚信,没有人能熄灭满天星光。今天,鸿蒙大势已定。”余承东说。

据大会现场介绍, HarmonyOS NEXT首次将AI能力融入系统,赋能生态。围绕图像智能、通话智能、文档智能、跨应用协同等,华为全面构筑了开放给应用的AI能

力,将与开发者共同打造生态级的鸿蒙原生智能。

余承东宣布,即日起,正式面向开发者和先锋用户启动HarmonyOS NEXT Beta测试,8月将发布面向消费者用户的Beta版本。“我们预计HarmonyOS NEXT将在今年四季度随着华为Mate70的上市,真正走向大规模商用。”余承东说。

此次开发者大会上,华为还发布了《鸿蒙2023白皮书》,同时,下一代编程语言仓颉和下一代AI辅助编码IDE等工具开启预览。

“盘古”上新“夸父”提速

紧随HarmonyOS NEXT之后,盘古大模型5.0登场。

“‘夸父’,能与我击个掌吗?”当张平安的右手与搭载盘古能力的人形机器人的银色手掌完成触碰时,盘古大模型的能力再一次得到验证。

盘古大模型5.0在全系列、多模态、强思维三个方面带来全新升级。记者在现场了解到,盘古大模型5.0包含不同参数规模的模型,以适配不同的业务场景。

张平安分享了盘古大模型在工业设

计、建筑设计、具身智能、媒体生产和应用、高铁、钢铁、气象等领域的丰富创新应用和落地实践,持续深入行业解难题。

此次华为开发者大会上,“夸父”人形机器人亮相。记者了解到,该款人形机器人是华为云与乐聚机器人战略合作的阶段性成果。搭载了盘古具身智能大模型的人形机器人在智能化、泛化能力上得到显著提升。

“一直以来,华为云盘古大模型都坚定地聚焦行业,在解难题、做难事的道路上不断攻坚克难,砥砺前行,重塑千行万业。”张平安透露,过去一年,盘古大模型已在30多个行业、400多个场景中落地。

华为云还对昇腾AI云服务进行持续优化。记者了解到,业界万亿参数模型训练的平均无中断时长约2.8天,而昇腾AI云服务可实现40天无中断;业界平均集群故障恢复时间约60分钟,昇腾AI云服务则可以缩短至10分钟,同时能将大模型的资源开通时间从月级缩短至天级,加速大模型的开发。

目前,昇腾AI云服务已全面适配行业主流的100多个大模型,以云服务的方式协助客户开发、训练,托管和应用模型,打造百模千态的“黑土地”。

天齐锂业智利项目“公私合营”计划将继续实施

◎记者 李少鹏

南美部分国家锂资源国有化的步伐提速,或让国内企业出海“淘矿”的复杂性逐步加大。

天齐锂业近日披露了海外重要参股公司SOM与智利国家铜业公司(简称“智利铜业公司”)拟成立合营公司的最新进展,大致内容为天齐锂业子公司天齐智利在5月21日向智利金融市场委员会(简称“CMF”)提出的禁令请求(即该交易须在SOM股东大会上获得三分之二有投票权的股份的批准)未被接受,SOM与智利铜业公司的“公私合营”计划的先决条件之一得以部分满足,后续有望继续实施。

据天齐锂业公告,SOM与智利铜业公司的“公私合营”计划有可能导致其在SOM的股东权利行使受到影响;但由于SOM与智利铜业公司之间的交易将在2025年完成,因此不会对天齐锂业2024年业绩产生不利

影响,目前公司也不需要计提减值准备。同时,合营公司成立后,SOM主要资产阿塔卡马盐湖的开采权也将由2030年延长至2060年,作为SOM第二大股东的天齐锂业仍能享受到股东应有的利益。上海证券报记者注意到,相较于此前Corfo(智利政府经济部下属的生产促进局)授予SOM的盐湖开采配额只到2030年底,通过“公私合营”,矿权配额确定性得以落实。

天齐锂业对SOM与智利铜业公司成立合营公司提出的权利诉求目前未得到智利相关部门认可。

具体来看,天齐锂业6月20日公告称,智利当地时间6月18日,CMF发布了一份名为《CMF关于对天齐智利提交材料的回复》。CMF认为,《合伙协议》不适宜由SOM的特别股东大会作出裁决,该交易应由SOM的董事会进行分析和决议。因此,CMF不同意天齐智利的诉求。

天齐锂业提出诉求的主要事项正是围

绕SOM与智利铜业公司的“公私合营”计划展开。

回溯来看,SOM与智利铜业公司在5月31日签署《合伙协议》,双方计划成立合资公司,以开发SOM目前从智利生产促进局租赁的阿塔卡马盐湖地区,主要负责开采及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售。根据《合伙协议》智利铜业公司将拥有合营公司50%+1股的股份,SOM将拥有50%-1股的股份,合营计划拟于2025年生效。

在利润分配方面,协议约定2025年至2030年,智利铜业公司将参与合营公司的部分碳酸锂当量的利润分配;2031年之后,SOM和智利铜业公司将基本按照股权比例分配利润。

事实上,SOM与智利铜业公司在2023年底就签署了关于“公私合营”的谅解备忘录,随后天齐锂业曾两度向SOM发出召开信息性股东大会的要求,并提出由股东大会投票表决谅解备忘录所载交易的要求,但是SOM拒绝了天齐锂业投票表决的要求。

天齐锂业进而在今年5月21日委托智利律师向CMF提交了“关于要求SOM就与智利铜业公司达成上述交易一事召集特别股东大会或者采取CMF认为必要的所有其他预防或纠正措施的申请”。然而,该申请目前也未被接受。

资料显示,SOM是全球重要的钾、锂等产品生产企业,运营着全球储量最大且品位最高的锂盐湖阿塔卡马盐湖。过去两年,受益于锂价狂飙,SOM业绩表现抢眼。财务数据显示,SOM2021年至2023年分别赚得5.86亿美元、39.06亿美元、9.23亿美元。

作为SOM第二大股东(持股比例为22.16%)的天齐锂业也是充分受益。据披露,2021年至2023年,SOM为天齐锂业带来的投资收益分别为7.6亿元、56.41亿元、29.31亿元。

由于SOM与智利铜业公司的合作伙伴关系拟于2025年生效,天齐锂业预计其不会对2024年的财务状况、经营成果造成重大影响。

■记者观察

“企二代”应该创造性接班

◎柴刘斌

近日,A股两家公司海南瑞泽和狮头股份相继迎来“00后”董事长或总裁,让资本市场感受到一股新风向。

狮头股份公告称,聘任吴锐怡为公司总裁。从简历来看,这位总裁出生于2000年5月份,硕士毕业于哥伦比亚大学。该消息一出,引发不少网友讨论,“00后女生成为上市公司总裁”的话题还一度冲上热搜榜。

从时间线上来看,A股市场成立已有三十多年,中国第一代的上市公司创业者中有一部分已退居幕后,年轻一代走向台前接手公司的案例不断增加。据最新统计,A股市场已经迎来了至少3位“00后”高管,除了吴锐怡,还有海南瑞泽董事长张源铿、鑫磊股份总

经理钟佳好。如果将范围扩大到“95后”,则有10位董事长、2位总裁和4位总经理。其中,有12例属于“企二代”接班。

上述“00后”上市公司高管中,张源铿创始成立海南路易斯张体育文化发展有限公司,还曾担任Louis Speed有限责任公司创始人兼首席执行官。在有了两段创业经历的磨炼之后,张源铿于今年6月担任上市公司董事长。

上市公司不同于一般的企业,需要对全体股东负责,其背后的资本运作也更为复杂。因此在有人感叹这些高管年轻有为之际,也出现不少质疑的声音:年纪轻轻真的能担起如此重任吗?

在回答这个问题之前,首先要思考,什么样的人适合接班。专业学识和丰富阅历是不可或缺的要素。从公布了学历情况的高管来

看,14名“95后”高管皆为本科或硕士学历,其中有不少就读企业管理、经济学、市场营销等专业,毕业院校大多为国外知名高校,如加利福尼亚大学伯克利分校、新南威尔士大学等;从工作经验来看,有不少“95后”高管有过在企业任职经历,如茂化实华董事长刘汕曾在美国投资管理公司任职两年多,春立医疗董事长史文玲则曾任职于字节跳动用户增长部门。

这些“95后”董事长或者总裁、总经理站在父辈们的肩膀上,获得了更好的教育,见识了更广阔的世界,大多拥有国际视野和现代化管理思维。企业成长需要注入现代化的技术与管理思想。因此,“企二代”接班有其优势。

“企二代”的接班,更需要创造性。在众多老一辈企业家的眼里,与其说是接班,不如说

是传承。他们希望看到的是二代人能够秉承自己创业的初心,将企业做大做强。在如今变化多端的市场,营销渠道、品牌运营、管理模式等都面临数字化、智能化、国际化等挑战。因而,对“企二代”来说,接下父辈手中的企业,既需要开拓进取的勇气,也需要创新的思维。

舆论对于这些年轻的二代们,不妨多一些宽容,想当年他们的父辈也是从年轻时一路创业成长起来的。对老一辈的创业者而言,既然对接班人委以重任,就应对他们多一些信任,多给一些试错机会。创新本质上是面向未知领域的探索,只有营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围,才能推动企业的蓬勃发展。

“企二代”需要通过创造性接班,才能带领公司在不断变化的世界,传递创业初心,承接企业责任。

AI拉动先进封装市场需求 产业链公司抢抓机遇

◎张梓桐 记者 李兴彩

“现在主要封装厂的产能利用率都比较高了。更重要的是,AI带动高性能计算芯片、存储等需求快速增长,使得半导体封装技术的重要性提升至前所未有的高度,给芯片封测厂商带来新发展机遇。”有半导体业内人士接受上海证券报记者采访,透露了半导体封装产业复苏的最新动向。

半导体市场研究机构TechInsights最新公布的2024年第一季度先进封装设备市场数据显示,2024年用于先进封装的晶圆厂设备预计将同比增长6%,达到31亿美元。

AI拉动先进封装市场需求

近日,A股先进封装板块走高,气派科技接连涨停,晶方科技、光智科技、佰维存储等明显上涨。记者了解到,半导体封装板块异动,原因之一是产业复苏显著,业内多家公司产能利用率大幅提升。

“现在主要封装厂的产能利用率都比较高,很多产线都接近满产。”有封装业内人士接受采访时表示,产业复苏显著,景气度在持续提升。

甬矽电子也对记者表示,公司5月份产能利用率就处在相对饱和状态,现在部分产线已经满产。从公司情况观察,下游客户去库存周期已基本完成,随着新客户的进一步导入与放量,公司未来的订单情况还会更加乐观。

更为重要的是,除了下游需求复苏带动产业景气度上升,AI带动高性能计算芯片、存储等需求快速增长,使得半导体封装技术的重要性提升至前所未有的高度,给产业链带来全新的增长和投资机遇。

半导体封装,是将集成电路芯片或其他半导体器件封装在一种保护性外壳中,以提供机械支持、电气连接和环境保护。AI发展极大催生了对先进封装的需求。

上述封装业业内人士表示,随着半导体工艺制程技术的持续演进,晶体管尺寸的微缩已经接近物理极限,芯片制造良率和成本、芯片功耗及性能也越来越难以平衡,行业进入“后摩尔时代”。先进封装技术能在不单纯依靠芯片制程工艺突破的情况下,通过晶圆级封装和系统级封装提高产品集成度实现功能多样化,满足终端需求并降低成本,成为提升芯片整体性能的主要路径之一。

一般认为,先进封装技术包括晶圆级封装(WLCSP)、3D堆叠封装、系统级封装(SiP)、Chiplet(芯粒)等多种形式,CoWoS就属于Chiplet的一种。“Chiplet封装将会是先进封装技术的重要发展方向,可以把不同类型的芯片和器件集成在一起,以实现更高的性能、更低的功耗和更好的可靠性。”长电科技汽车电子事业部副总裁、总经理兼长电汽车电子上海有限公司总经理郑刚介绍。

产业链公司迎新发展机遇

随着先进封装市场持续增长,A股半导体封装产业链上的公司也迎来发展新机遇,国内几大封装公司纷纷通过技术研发、并购等方式,提升先进封装水平和市场份额。

甬矽电子表示,公司继续加码先进封装,近期披露了可转债募投项目“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”,该项目计划投资14.64亿元。目前,公司SiP封装、倒装等先进产能占比合计约70%。

通富微电在近期接受机构调研时介绍,公司先进封装技术布局占比超六成,为保持封装技术上的各项优势,公司计划2024年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计48.90亿元。公司还与AMD已形成了“合资+合作”的强强联合模式,建立了紧密的战略合作伙伴关系。

长电科技则通过并购进入存储封装领域。今年3月,长电科技宣布通过旗下子公司,以6.24亿美元现金收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权。华天科技近期表示,仍将积极寻找符合公司发展战略的并购项目,通过资源整合,不断提升公司封装技术水平,优化客户结构,提高市场份额。

“先进封装对设备的要求更高、更接近于前道晶圆制造,而且有不少特有工艺要求。一条有一定规模的完整先进封装生产线要投资40亿元至60亿元,其中八成投资用于设备购买。”易卜半导体创始人、董事长李维平介绍,先进封装尤其是Chiplet发展,给等离子蚀刻、电镀、混合键合等半导体设备带来新的增长市场。

中微公司相关人士告诉记者,TSV(硅通孔)是Chiplet中关键工艺之一,中微公司的深硅刻蚀机和介质刻蚀机都应用到了这类先进封装中。据披露,中微公司近两年新开发的LPCVD(低压型化学气相沉积)设备和ALD(原子层沉积)设备,目前已有四款设备产品进入市场,其中三款设备已获得客户认证,并开始得到重复性订单。

盛美上海近日在接受机构调研时介绍,先进封装的市场具备很大的成长空间,预计公司先进封装设备占整体营收比例将在10%-15%。公司具备全面的先进封装设备布局,随着国内封装厂对2.5D、3D封装需求的增长,公司上述设备产品的国内订单获取将存在较大提升空间,并在向美国、韩国市场拓展。

此外,先进封装的发展给半导体材料公司也带来新的机遇。艾森股份近日表示,公司现有量产产品先进封装负性光刻胶、电镀铜基液、铜钨蚀刻液以及客户认证中的电镀锡银添加剂等产品,可以用于HBM存储芯片封装。

国泰君安研报显示,据测算,预计2021—2025年中国先进封装设备市场规模CAGR为24.1%,到2025年有望达到285.4亿元。